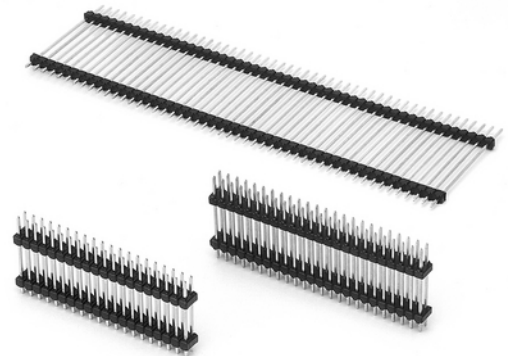


# 949 / 950 / 951

## Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

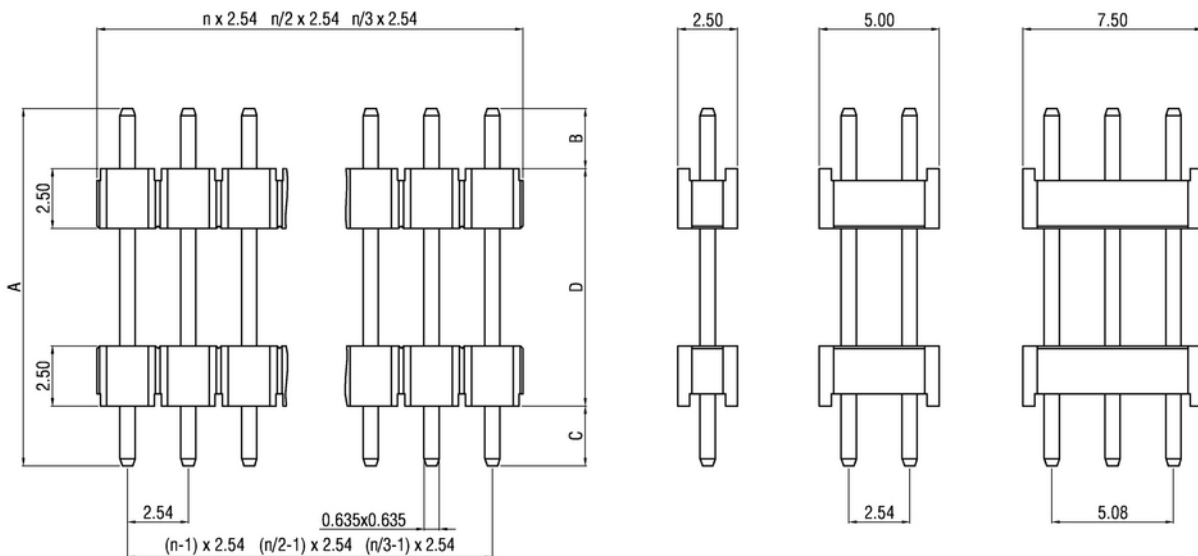
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.635mm, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>DC</sub> <i>1kV<sub>DC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V <sub>AC</sub> <i>250V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serien:  
*Mate with Female Header Series:*  
**153 154 157 159 160/162 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



### Series\*

**949**

#### Gestanzte/geprägte Kontakte

*Stamped/formed contacts*

**949** Einreihig

*Single row*

**950** Zweireihig

*Double row*

**951** Dreireihig

*Triple row*

### Dimensions\*

**19**

<b>16</b>	A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm
<b>17</b>	A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm
<b>18</b>	A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm
<b>19</b>	A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm
<b>20</b>	A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm
<b>21</b>	A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm
<b>22</b>	A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm
<b>23</b>	A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm
<b>24</b>	A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm
<b>25</b>	A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm
<b>26</b>	A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm

### Contacts\*

**010**

**001-050** Einreihig

*Single row*

**004-100** Zweireihig

*Double row*

**006-120** Dreireihig

*Triple row*

### Plating\*

**00**

**00** Vergoldet

*Gold plated*

**10** 0,25µm Gold

*0.25µm gold plated*

**30** 0,75µm Gold

*0.75µm gold plated*

**50** Verzinkt

*Tin plated*

**60** Sel. Au 0,25µm / Sn

**80** Sel. Au 0,75µm / Sn

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage.  
*B, C, D variable acc. to customers' specifications. We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request.*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* *This is an order example - please replace by your specifications.*

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

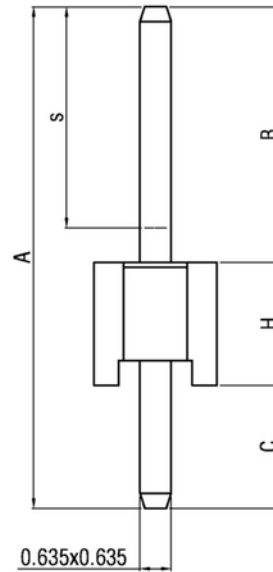
# Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

## Dimensions and PCB Layouts

### Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

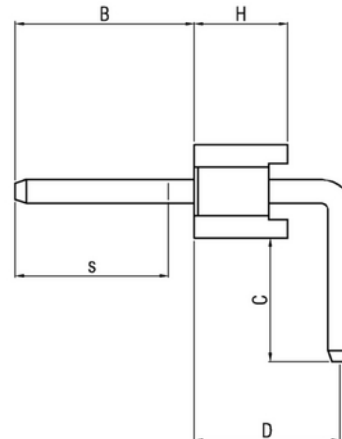
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



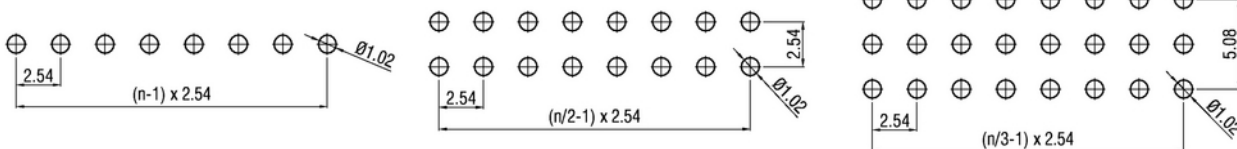
### Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



### PCB Layouts



## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

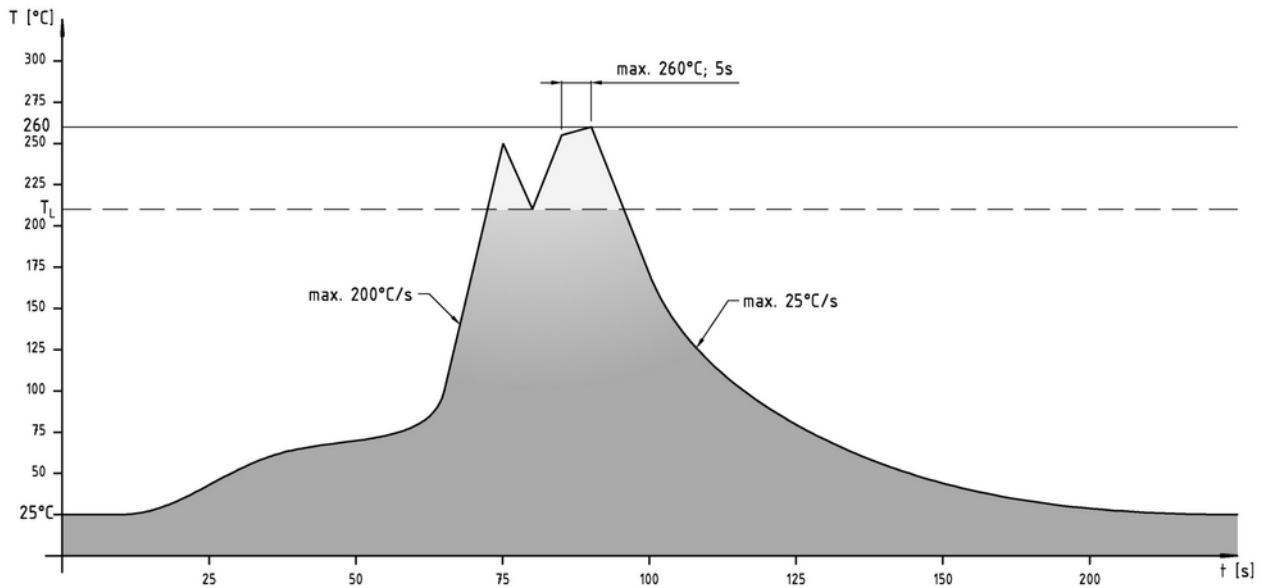
### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:



# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

